

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】令和4年5月10日(2022.5.10)

【公開番号】特開2021-130739(P2021-130739A)

【公開日】令和3年9月9日(2021.9.9)

【年通号数】公開・登録公報2021-042

【出願番号】特願2020-25271(P2020-25271)

【国際特許分類】

C 08 J 9/16 (2006.01)

10

【F I】

C 08 J 9/16

C F G

【手続補正書】

【提出日】令和4年4月26日(2022.4.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【特許請求の範囲】

【請求項1】

X線回折法により測定される結晶子サイズが8nmを超える、ポリアミド系樹脂発泡粒子。

【請求項2】

JIS K7122-1987の熱流束示差走査熱量測定法に基づき、ポリアミド系樹脂発泡粒子を試験片とし、加熱速度10 /分にて30から融解ピーク終了時よりも30高い温度まで加熱する際に測定されるDSC曲線の全融解熱量が40~140J/gである、請求項1に記載のポリアミド系樹脂発泡粒子。

【請求項3】

ポリアミド系樹脂発泡粒子の見掛け密度が10~300kg/m³である、請求項1又は2に記載のポリアミド系樹脂発泡粒子。

【請求項4】

下記の条件1にて得られる第2回加熱のDSC曲線の融解ピークの頂点温度が185~285である、請求項1~3のいずれか1つに記載のポリアミド系樹脂発泡粒子。

条件1

JIS K7121-1987の熱流束示差走査熱量測定法に基づき、ポリアミド系樹脂発泡粒子を試験片とし、加熱速度10 /分にて30から融解ピーク終了時よりも30高い温度まで加熱し、その温度にて10分間保った後、冷却速度10 /分にて30まで冷却し、再度、加熱速度10 /分にて融解ピーク終了時よりも30高い温度まで加熱する際に測定されるDSC曲線を第2回加熱のDSC曲線とする。

【請求項5】

X線回折法により測定されるポリアミド系樹脂発泡粒子の結晶子サイズが9nm以上である、請求項1~4のいずれか1つに記載のポリアミド系樹脂発泡粒子。

【請求項6】

X線回折法により測定されるポリアミド系樹脂発泡粒子の結晶子サイズが10nm以上である、請求項1~5のいずれか1つに記載のポリアミド系樹脂発泡粒子。

【請求項7】

ポリアミド系樹脂発泡粒子の独立気泡率が90%を超える、請求項1~6のいずれか1つに記載のポリアミド系樹脂発泡粒子。

50

【請求項 8】

ポリアミド系樹脂発泡粒子の平均気泡径が 20 ~ 200 μm である、請求項 1 ~ 7 のいずれか 1 つに記載のポリアミド系樹脂発泡粒子。

【請求項 9】

ポリアミド系樹脂発泡粒子の表層膜厚が 5 ~ 50 μm である、請求項 1 ~ 8 のいずれか 1 つに記載のポリアミド系樹脂発泡粒子。

10

20

30

40

50